

医歯工連携実用化シーズ・ニーズ登録票

1. **登録年月日.** 2012年5月12日
2. **情報公開の設定.** 公開
3. **種別.** シーズ
4. **名称.** 骨膜下埋植デバイスのための骨接合促進表面処理法
5. **要点.** 骨膜下に埋植して用いられるデバイスにおいて、骨接合を促進するために利用される表面処理法。歯科矯正用アンカーなどのデバイスなどに利用すれば、従来の純 Ti 材や HAp コーティングされた Ti 材よりも速やかな骨への接合が可能になる。
6. **概要.** 骨膜下に埋植して骨への接合を図る骨膜下埋植デバイスは、骨実質に対する侵襲性が低いという利点を有しているが、骨への接合に長期間を要するという問題点が残されている。これはデバイスの埋植手術時において骨膜を剥離する際に造骨性の細胞がほとんど死滅するために、埋植された材料が線維組織でカプセル化されるためである。本発明では速やかに生体内で貪食されて造骨反応を惹起する HAp/Col 材料を利用してこのカプセル化反応を抑制し、従来の純 Ti 材や HAp コーティングされた Ti 材よりも速やかな骨への接合を可能とするものである。具体的には矯正歯科用のアンカリングデバイスとしての実用化を目指す。
Ti: チタン, HAp: ハイドロキシアパタイト, HAp/Col: ハイドロキシアパタイトコラーゲン複合体。
7. **知的所有権.** 特願 2012-096056 HAp/Col によって被覆された医療用材料
8. **希望提携先.** 歯科材料メーカー, 整形外科用材料メーカーなど
9. **参考資料その他.**
なし
10. **連絡先.** 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 医歯工連携実用化施設
高久田和夫 takakuda.mech@tmd.ac.jp